

2025 台日科技高峰論壇

—從設計到應用：台日半導體民主供應鏈—

From Design to Application: Taiwan-Japan Democratic Semiconductor Supply Chain

Sept. 8th & 9th

地點：台北國際會議中心

DOIT 經濟部產業技術司
Department of Industrial Technology, MOEA

CIER 中華經濟研究院
CHUNG-HUA INSTITUTE FOR ECONOMIC RESEARCH

本研討會為中日同步口譯，可登錄公務人員學習時數

面對地緣政治風險升高與全球科技競爭白熱化，半導體產業已成為各國戰略布局核心。為深化臺日科技戰略夥伴關係，構建具韌性之民主供應鏈體系，本高峰論壇以「從設計到應用：臺日半導體民主供應鏈」為主軸，匯聚兩國產官學研領袖，探析全球趨勢與雙邊合作機制。

論壇設置四大核心議程從產業鏈出發剖析「全球半導體產業發展趨勢」：議題一「半導體設計未來趨勢與台日合作方向」聚焦AI晶片架構、先進封裝、低功耗設計技術，深化雙方技術專長與應用場域之互補性；議題二「異質整合趨勢與供應鏈生態系」整合臺日關鍵設備與技術供應商，建構前瞻性合作框架；議題三「台日半導體關鍵材料之合作契機」針對晶圓材料、特殊化學品及製程等領域，強化產業鏈垂直整合；議題四「半導體先進檢測與展望」探討量測技術創新、AI輔助檢測系統與品質管控標準。

本論壇呼應臺灣「半導體先進製程中心」戰略方針與日本「次世代半導體技術開發」政策藍圖，促進雙邊政策協調與技術對接。期透過本次交流平台，推動臺日共構具戰略自主性與可持續發展之半導體價值鏈，開創台日合作新典範。

■ 主辦單位：經濟部產業技術司

■ 執行單位：財團法人中華經濟研究院

■ 舉辦時間：2025 年 9 月 8 日（一）10:00-17:00（09:30 開始報到）、
9 月 9 日（二）09:30-12:40（09:00 開始報到）

■ 舉辦地點：台北國際會議中心 201 ABC 會議室（台北市信義區信義路五段 1 號）

■ 邀請對象：相關領域之產官學研人士（優先報名）

■ 大會語言：中文、日文（同步口譯）

■ 報名方式：<https://seminar.cier.edu.tw/Regfrm.asp?id=20250908>

■ 報名截止：免費報名，即日起至額滿為止（預定 250 名）

■ 活動網頁：<https://reurl.cc/dalGX6>

■ 洽詢電話：02-2735-6006 #5264 李小姐 中華經濟研究院日本中心
或 e-mail: tnstinfo@cier.edu.tw

■ 注意事項：

1. 本活動採預先線上報名，請填寫真實資料，主辦單位保留報名資格最後審核權。
2. 審核通過者，將於 9/4（四）以電子郵件方式寄送「報到通知」至指定電子信箱，以作為報到憑證。
3. 本活動提供與會者登錄「公務人員終生學習時數、研習證明」服務。
4. 若因不可抗拒之因素，主辦單位得不經預告，保有變更活動議程及講師之權利。

2025台日科技高峰論壇

— 從設計到應用：台日半導體民主供應鏈 —

《議程表》

【第一天】09/08 (週一)

地點：台北國際會議中心 201 會議室

台灣時間	議 題	講 者
09:30-10:00	會場報到	
10:00-10:20	【主辦單位致詞】	
	郭 肇中 (Dr. Chaochung KUO) 司長 經濟部產業技術司	
	【貴賓致詞】	
	何 美玥 (Meiyueh HO) 國策顧問 中華民國總統府 川合 現 (Gen KAWAI) 副代表 公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所	
	【執行單位致詞】	
	連 賢明 (Prof. Hsienming LIEN) 院長 財團法人中華經濟研究院	
	《紀念合影》	
10:20-11:20	【專題演講一】	
	引言人：服部 崇 (Prof. Takashi HATTORI) 特定教授 京都大學先端政策分析研究中心	
	全球半導體產業發展趨勢	曹 世綸 (Terry TSAO) 全球行銷長暨台灣區總裁 國際半導體產業協會 (SEMI)
	學研引領、政府協力： 次世代半導體產業發展新模式	橋本 和仁 (Prof. Kazuhito HASHIMOTO) 理事長 國立研究開發法人科學技術振興機構 (JST)
	日本量子技術戰略及發展	堀部 雅弘 (Dr. Masahiro HORIBE) 副中心長 國立研究開發法人產業技術總合研究所 (AIST) G-QuAT
11:20-13:10	午餐時間 Lunch	
13:10-15:00	【議題一】半導體設計未來趨勢與台日合作方向	
	場次座長：楊 佳玲 (Prof. Chialin YANG) 特聘教授/副主任 國立臺灣大學資訊工程學系/國科會科技政策諮詢專家室	
	半導體產業發展與 AI 未來趨勢	梁 伯嵩 (Prof. Borsung LIANG) 資深處長 / 客座教授 聯發科技 (MediaTek) / 國立臺灣大學資訊工程學系
	強化日台半導體設計合作之策略方針 — 構建矽谷產業帶之願景 —	安浦 寬人 (Dr. Hiroto YASUURA) 副所長 / 獨立董事 國立情報學研究所 (NII) / 益芯科技 (CMSC)
	異質整合的最新趨勢及其應用實例	水野 潤 (Prof. Jun Mizuno) 教授 國立成功大學智慧半導體及永續製造學院
	綜合討論 Q & A	
15:00-15:10	中場休息 Coffee Break	
15:10-17:00	【議題二】異質整合趨勢與供應鏈生態系	
	場次座長：李 昇憲 (Prof. Shengshian LI) 講座教授 國立清華大學動力機械工程學系	
	提升半導體製造設備 LTV 的台日合作	中村 道也 (Michiya NAKAMURA) 取締役專務執行役員 meister
	大航海時代：先進封裝供應鏈應變策略	梁 又文 (Frank LIANG) 總經理 志聖工業 (C SUN)
	當亂度相遇文化： 異質整合與臺日新距離的啟示	吳 東嶸 (Stanley WU) 總經理 優貝克科技 (ULVAC)
	綜合討論 Q & A	
	【閉幕致詞】	
	江 泰瑾 (Prof. Taichin CHIANG) 主任 / 特定准教授 中華經濟研究院日本中心 / 東京科學大學工學院	

【第二天】09/09 (週二)

台灣時間	議 題	講 者
09:00-09:30	會場報到	
09:30-10:00	【專題演講二】	
	引言人：服部 崇 (Prof. Takashi HATTORI) 特定教授 京都大學先端政策分析研究中心	
	新興矽島九州的設計藍圖	岡野 秀之 (Prof. Hideyuki OKANO) 常務理事 公益財團法人九州經濟調查協會
10:00-11:10	【議題三】台日半導體關鍵材料之合作契機	
	場次座長：洪 瑞華 (Prof. Rayhua HORNG) 講座教授 國立陽明交通大學電子研究所	
	(講題確認中)	李 文中 (Wenchung LEE) 技術長 合晶科技 (Wafer Works)
	氧化鎵功率元件發展現況	倉又 朗人 (Akito KURAMATA) 代表取締役社長 Novel Crystal Technology
	綜合討論 Q & A	
11:10-11:20	中場休息 Coffee Break	
11:20-12:40	【議題四】半導體先進檢測與展望	
	場次座長：陳 明志 (Prof. Mingjyh CHERN) 院長 國立臺灣科技大學工程學院	
	先進 X 光計量技術於半導體領域 及其未來發展	尾形 潔 (Dr. Kiyoshi OGATA) 資深執行副總 Rigaku Holdings
	先進封裝缺陷檢測與展望	李 宏益 (Prof. Eric LEE) 董事長 / 執行長兼總經理 亞亞科技 (YAYATECH) / 辛耘企業 (SCIENTECH)
	綜合討論 Q & A	
	【閉幕致詞】	
	江 泰瑾 (Prof. Taichin CHIANG) 主任 / 特定准教授 中華經濟研究院日本中心 / 東京科學大學工學院	

註：主辦單位保留變更議程及講師之權利。